

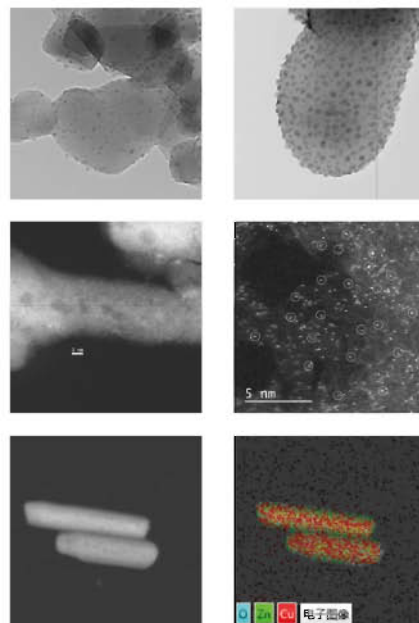
原子层沉积系统



主要特点

- 真空反应腔工作温度高达 400°C
- PID 自动控温，带模糊算法自整定
- 复杂管气路可最多具备八种前驱体、两路氧化还原气路和三路载气
- 满足特殊样品（粉末）要求
- 适合低蒸气压固态源的高温鼓泡器设计，有利于提高反应效率和重复性
- 反应过程可自行编程，实现不同类型 ALD 样品生长
- 全金属密封，适用于腐蚀性反应
- 实时测控气体流量和监测真空度
- 在线原位分析气体成分
- 自带臭氧发生器，反应残留物热分解装置
- 互联版可与超高真空系统互联，并兼容 MBE 标准旗型样品托
- 系统可定制和扩展

ALD 系统性能测试数据

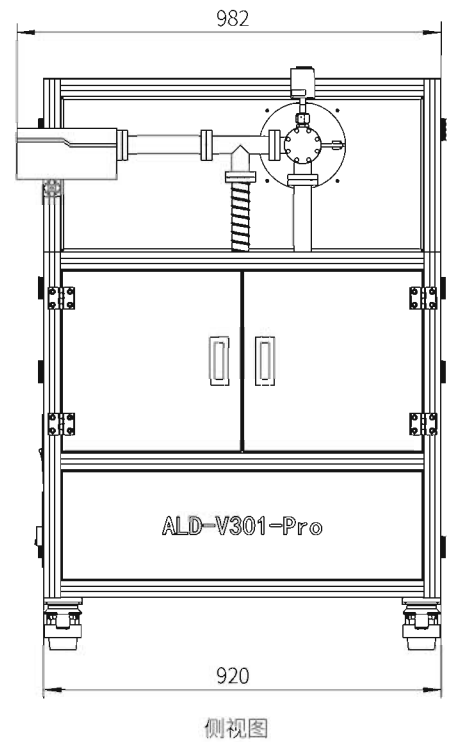
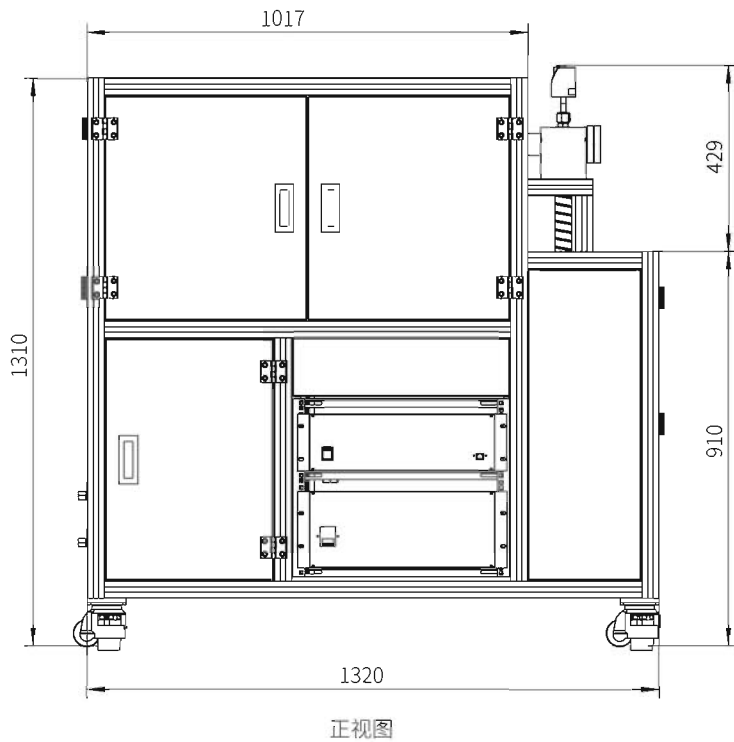


扫码关注

技术参数

主腔体	腔体尺寸	内径 40mm × 长度 980mm, 可定制其他尺寸
	材质	316SS
	工作温度	RT~400°C
	控温精度	±1°C
前驱体运输	4 个低温前驱体源 (RT~80°C)	[(CH ₃) ₃ Al] ₂ , [(CH ₃) ₃ Ge] ₂ , H ₂ O etc
	4 个高温前驱体源 (RT~300°C)	Fe(Cp) ₂ , Precious metal precursors
	控温精度	±1°C
气体流量控制	5 Gas flow controllers, 0~500 sccm	
载气	N ₂ , Ar	
反应气	O ₂ /O ₃ , H ₂	
控温路数	24 路, 可定制	
阀门控制路数	24 (Max)	
控制系统	主控单元, 加热单元, 测温单元	
软件控制	Labview 图形化设计, 友好的用户界面	

- 可选项
- 残余气体分析模块
 - 等离子体模块
 - 光学检测模块
 - QCM 原位监测模块



扫码关注